

非絶縁型小型3端子 DC/DCコンバータ

BP5275シリーズ (BP5275-50, BP5275-33, BP5275-25, BP5275-18)

降圧同期整流方式スイッチングレギュレータ

外付部品なしで高効率DC/DCを実現!

新製品
(3月リリース予定)

入出力に
コンデンサ不要

全ての部品を
TO-220サイズに
パッケージング

従来の実装表面積を
1/6に省スペース化

3端子LDOと
ピンコンパチブル可を
実現!

独自構造で高い
放熱効果を実現!
(放熱設計の必要なし)

同期整流方式で
高効率化と
省エネ効果を実現!

5.0V、3.3V、
2.5V、1.8Vを
ラインナップ予定!



省エネ・高効率・高放熱性で2010年縁起良し!!

主な仕様用途

- ◆ 溶接・搬送等、各種ロボット
- ◆ コンピュータ周辺機器(プリンタ、スキャナ等)
- ◆ LED等、各種表示器
- ◆ 医療機器
- ◆ 電子楽器関連
- ◆ 各種PA等、プロ用音響機器関連
- ◆ アミューズメント機器

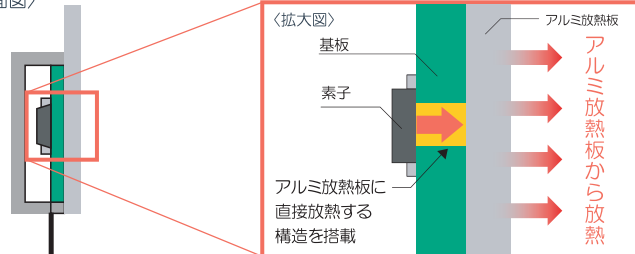
絶対最大定格

No.	項目	記号	定格	単位	備考
1	入力電圧	Vin	15	V	DC
2	動作温度範囲	Topr	-20 ~ 80	°C	
3	保存温度範囲	Tstg	-25 ~ 85	°C	
4	許容最大表面温度	Tcmax	105	°C	周囲温度+モジュールの自己発熱 ≤ Tcmax
5	出力最大電流	Iomax	500	mA	注1)

注1) ヒートシンク搭載時は800mA 出力可能

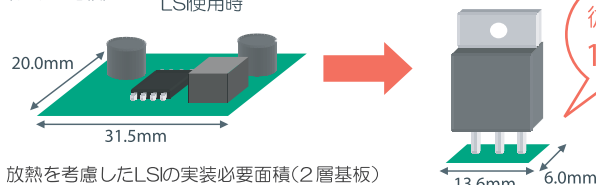
発熱素子からアルミ放熱板へ直接放熱できる基板構造を採用。放熱設計を行う必要がありません。またヒートシンク搭載可能な構造を採用しており、搭載時には出力電流をUpさせる事が可能です。

〈断面図〉



面実装型DC/DCコンバータICを使用した場合でも放熱は必要です。BP5275シリーズは放熱性に特に注目し、必要な実装面積を最小に抑えています。

〈サイズ比較〉



放熱を考慮したLSIの実装必要面積(2層基板)